

信大捷安 2018—2022 年规划实施重点项目汇总表

序号	项目名称	项目建设内容	生产能力	计划总投资 金额	2022 年预期 实现销售收入	备注
1	基于自主可信的 SOC 安全芯片项目	研究汽车级应用极端工作温度下的安全芯片设计技术,满足特殊环境下的安全应用需求;研究基于新工艺的静态和动态功耗控制技术,降低芯片功耗、减小芯片体积,降低成本;研究面向业务应用的密码算法动态可配置加速处理技术,提高安全芯片的应用处理性能。	年产 20 亿颗低功耗安全芯片(40nm)	8.2 亿元	160.02 亿元	
			年产 2000 万颗车规级安全芯片(含服务)(40nm)	3.8 亿元	26.90 亿元	
			年产 50 万颗服务器专用安全芯片(40nm)	2.2 亿元	6.00 亿元	
2	基于国密安全芯片的 NB-IOT 物联网安全模组关键技术研发及产业化	该项目研发、生产集成安全芯片和 NB-IOT 物联网芯片、符合 NB-IOT 网络标准的安全通信模组,为物联网设备生产厂商提供统一、完整、系统的安全物联网通信模组,提高设备的集成度,节省设备空间和功耗,降低 NB-IOT 设备研发复杂度。项目产品可广泛应用于基于广域的智能停车、智能水表、智能气表、环保监测等智慧城市基础设施中,有利于提高上述各个行业的智能化发展。	年产 1.4 亿块安全模组	3.5 亿元	24.00 亿元	
3	基于国密安全芯片的 LTE 物联网安全模组关键技术研发及产业化	针对工业控制,电梯,医疗等领域嵌入式终端存在的数据安全、网络安全、身份认证等安全问题,基于自主可控芯片和国密算法,研制融合多种通讯协议一体化的高等级安全模组,实现终端数据传输和身份认证的安全,解决单一通讯协议安全模块适配性差、安全强度低的问题。	年产 6000 万块安全模组	6.2 亿元	100.80 亿元	

4	移动智能终端公共服务平台建设	构建移动智能终端“芯—云—管—端”全方位的公共安全体系,为移动智能终端提供终端硬件级安全隔离、终端系统安全加固、移动安全接入、移动安全通信、终端标识管理、移动身份认证、移动设备安全管理等一系列安全服务,解决移动智能终端运行环境安全及移动身份认证等核心安全问题,通过云服务模式为国内移动金融/支付、移动办公、智能网联汽车等高敏感应用提供信息安全服务。	具备支撑5亿用户,1亿高速物联网连接,100亿级低速物联网连接提供安全服务能力	10.8亿元	78.34亿元	
		建设面向移动互联网信任体系建设的智能终端大数据服务中心项目,解决“我是谁”、“你是谁”、“终端设备可信”等问题,突破不同部门、不同领域、不同行业均具有的网络信任难题。	主要资源数据规模达到900TB数据	1.5亿元		
5	基于国产安全芯片的“全终端”型态安全智能终端关键技术研发及应用示范	项目研发基于国产安全芯片,内置国密算法的安全智能终端;实现终端环境安全、数据存储安全、数据通信安全、通话安全;基于外置蓝牙密码模块,实现终端自动解锁、自动锁定、密钥自动销毁等功能。与终端厂商合作,将内置国产安全芯片的“全终端”型态安全智能终端推广至公安,税务等政务领域,进行行业应用示范。	年产300万部移动安全智能终端	15.8亿元	60.00亿元	
6	专用安全服务器的技术研发及应用示范	研究基于专用安全芯片的服务器,可满足服务器环境的计算需求,提供PKCS、国密等标准化的密码服务,具备完善的密钥管理功能,并提供高效的密码运算能力和对虚拟化的支持。可广泛应用于金融云、政务云、警务云、云存储、云备份等云平台环境下,也可为大数大集中模式提供高性能、高可靠性的密码运算服务。	年产1万台专用安全服务器	0.8亿元	—	
7	信息安全产业示范基地建设	全力建设国密安全芯片设计研发中心、信息安全产品测评中心、安全智能硬件研发与制造基地、公共安全服务云平台基地“两中心两基地”建设,构建“芯片+终端+软件+服务”全产业链发展格局。	建成在全国有重要影响力和竞争力的千亿级信息安全产业示范基地	16.5亿元	4.8亿	安全平台销售
合计				69.3亿元	460.86亿元	